

参考基板レイアウト (マウント面)
RECOMMENDED P.C. BOARD
PATTERN DIMENSION. (REF.)
(MOUNTING AREA)

- 補強金具 : 錫メッキ
FITTING NAIL : TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
補強金具下地メッキ : ニッケルメッキ
UNDER PLATING : NICKEL (FITTING NAIL)
1.0 MICROMETER MINIMUM
- ③ (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
4 嵌合相手 : 53949 シリーズ
MATE WITH : 53949 SERIES.
5 テール及びネールの平坦度は、 ϕ .IMAX.
TAIL AND NAIL COPLANARITY TO BE ϕ .IMAX.
④ テール部に適用。
APPLY TO THE TAIL AREA.
⑤ ネール部に適用。
APPLY TO THE NAIL AREA.
- 8 本製品は 54150-***1 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 54150-***1.

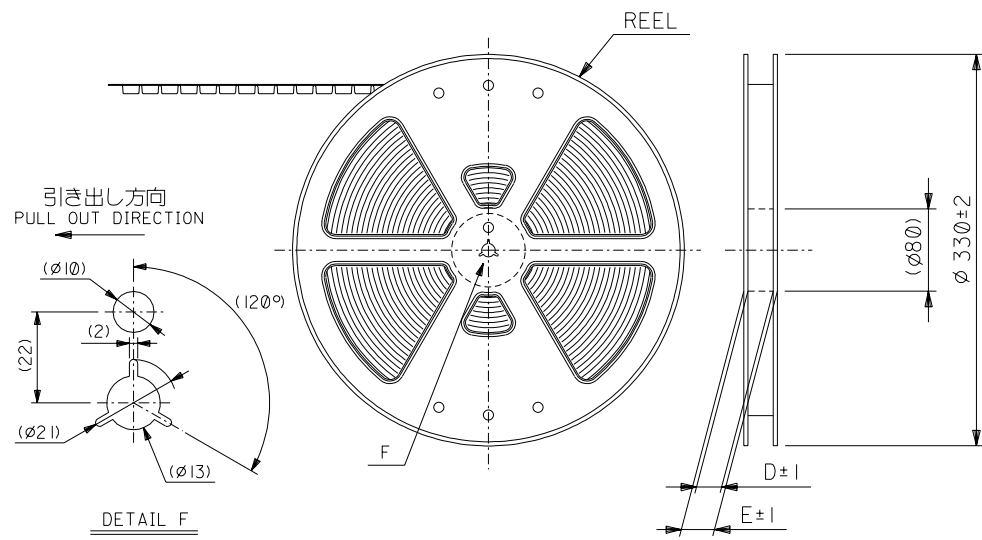
注記 NOTES:

- 使用材料 MATERIAL
ハウジング: ポリフタルアミド (PPA) ガラス充填
UL94V-0 (黒)
HOUSING: POLYPHTHAL AMIDE (PPA),
(GLASS FILLED) UL94V-0
(COLOR: BLACK)
ターミナル: リン青銅 (t=0.15)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
補強金具: リン青銅 (t=0.2)
FITTING NAIL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.2)
- メッキ仕様 PLATING
コンタクト部 : 金メッキ
CONTACT AREA : GOLD
テール部 : 金メッキ
TAIL AREA : GOLD
ターミナル部下地メッキ : ニッケルメッキ
UNDER PLATING : NICKEL (TERMINAL AREA)

20.5	19.5	23.9	54150-0871	80
18	17	21.4	54150-0771	70
15.5	14.5	18.9	54150-0671	60
13	12	16.4	54150-0571	50

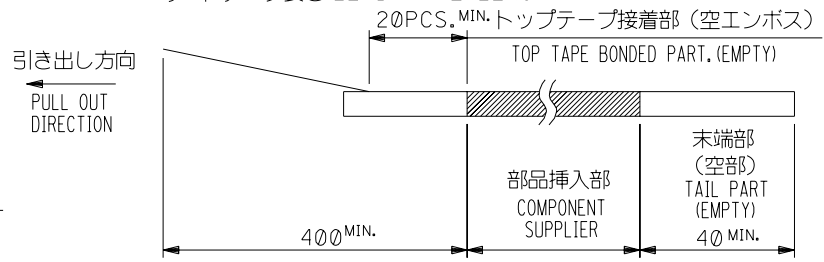
MODEL NO.	54150-***71	C	B	A	MATERIAL NO.	CIRCUIT
-----------	-------------	---	---	---	--------------	---------

角度 ANGLE		±3°	材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
30°以上 OVER		+0.3	仕上げ FINISH		//		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
10°以上 OVER 30°未下 UNDER		+0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE		//		TITLE 名称	
未下 UNDER		+0.2	被覆外径 INS. RANGE		//		0.5 B-To-B Rec Hsg Assy (Hgt=2.5) WITH NAIL -LEAD FREE-	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	新規作成 PROPOSED (J2004-2833)	日付 DATE	04/03/03	CHK'D BY 04/03/03	DWG. NO.	
		変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	04/03/03	尺度 SCALE	SD-54150-001	
							REV 0	

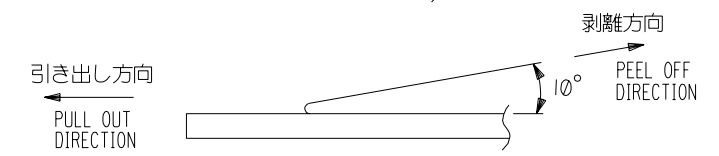


NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-54150-001 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-54150-001.
- 梱包数量：3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS：3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



- トップテープの剥離強度：0.1～1.3N {10～130gf} (剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE：0.1～1.3N {10～130gf}
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG,)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.



- 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE)：ポリプロピレン (POLYPROPYLENE (PP))
トップテープ (TOPTAPE)：PET, PE, PEF
リール (REEL)：ポリスチレン (P.S.) (POLYSTYRENE (PS))
リサイクル材を含む (RECYCLE MATERIAL CONTAINED)
- 本製品は 54150-***8 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 54150-***8.

		MODEL NO.		54150-***78	
		材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES	
		仕上げ FINISH		— # —	
		適用電線範囲 WIRE RANGE		— # —	
		被覆外径 INS. RANGE		— # —	
角度 ANGLE		±3°		DRAWN BY '04/03/03 H.KAWABATA	
30 以上 OVER		+0.3		CHK'D BY '04/03/03 K.TOJO	
10 以上 OVER 30 未満 UNDER		+0.25		DR. 日付 APP'D BY '04/03/03 M.SASAO	
10 未満 UNDER		+0.2		尺度 SCALE — # —	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	
		DR. CHK.		DATE	

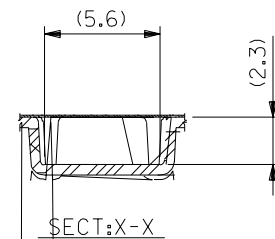
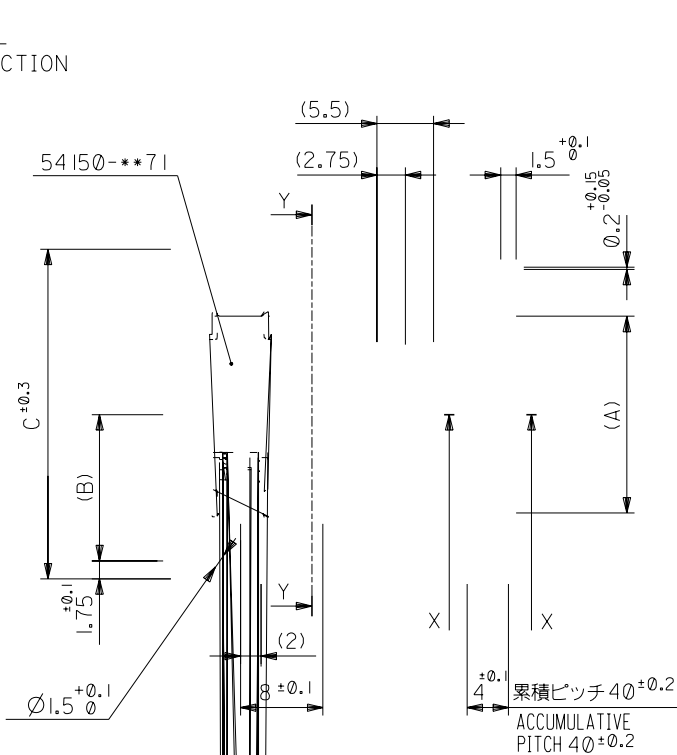
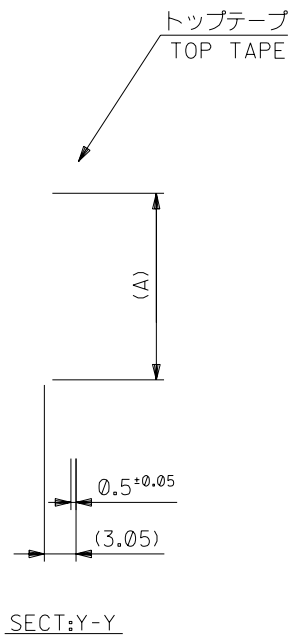
molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.5 B-To-B Rec Hsg Assy W/NAIL (Hgt=2.5) Embstp Pkg -LEAD FREE-

DWG. NO. (SHEET 1 OF 3) REV 0
SD-54150-002

PULL OUT DIRECTION



32mm幅キャリア
32mm WIDTH CARRIER TAPE

32	33.4	32	14.2			
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	54150-0578	50 極数

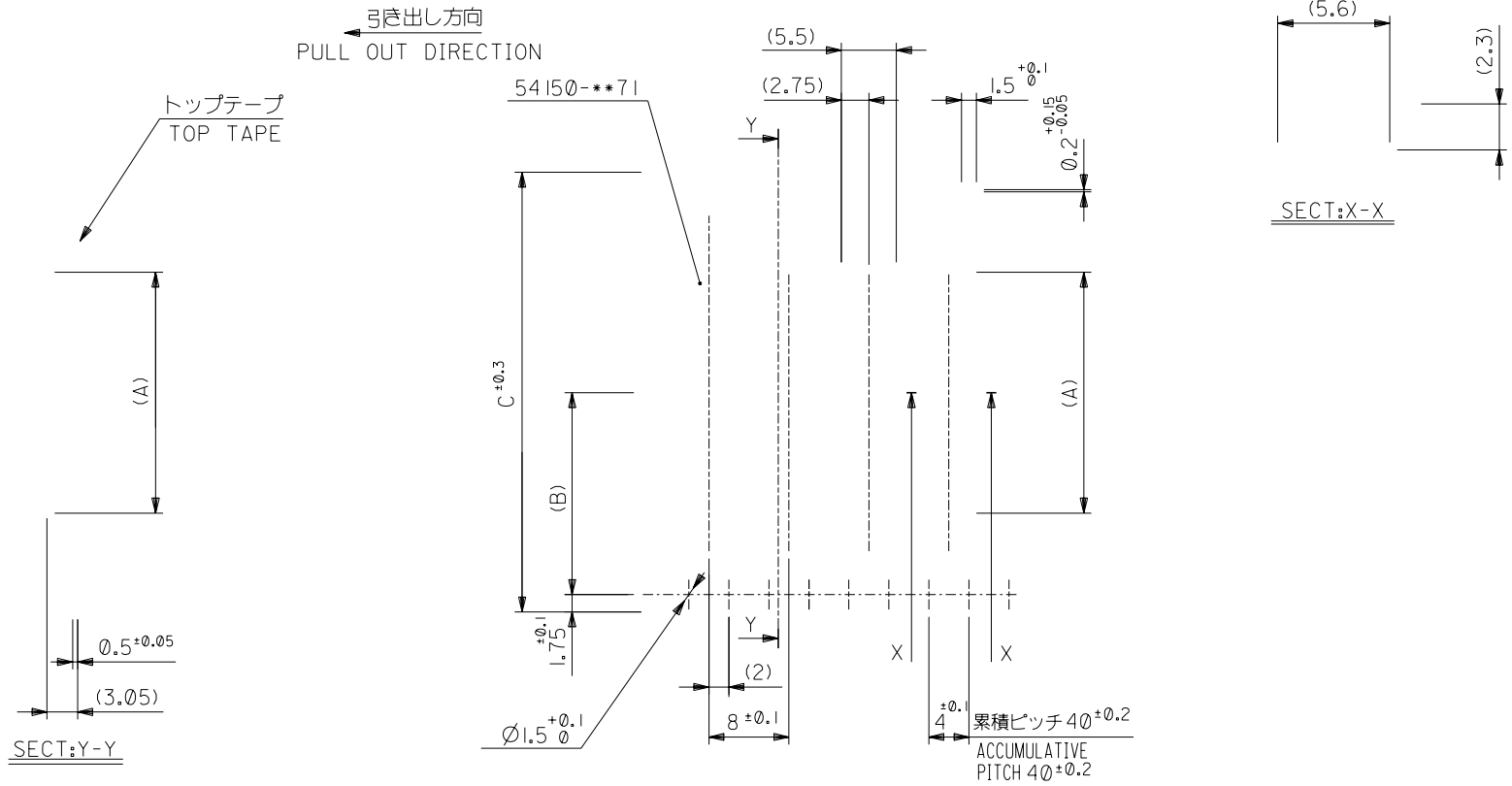
SHEET 1 OF 3 参照
REFER TO SHEET OF 3

PROPOSED

H.K
K.1

(SHEET 2 OF 3)

0



44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

54150-***78	44	49.4	45.4	44	20.2	24.1	54150-0878	80
MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種数 CIRCUIT

SHEET 1 OF 3 参照
REFER TO SHEET 1 OF 3



新規作成 (J2004-2833) 04/03/03
PROPOSED

H.KAWABATA
M.SASAO

K.TOJO

0.5 B-To-B Rec Hsg Assy
W/NAIL (Hgt=2.5) Embstp
Pkg -LEAD FREE-
(SHEET 3 OF 3)

SD-54150-002 0